**「2019 台灣•日本福井縣電子設備產業製造加工技術商機媒合會」**

**-活動報名表-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司資訊** | | | | |
| **公司名稱**  **(※必填)** | **（中）** | | | |
| **（英）** | | | |
| **公司官網** |  | | | |
| **設立時間** |  | **員工人數** | |  |
| **資本額** |  | **2018年營業額** | |  |
| **海外工廠** | **□無　□有：** | **海外銷售實績** | | **□無　□有：** |
| **公司簡介(※必填)** | | | | |
|  | | | | |
| **業務內容說明（技術優勢、產品等，可以照片說明）(※必填)** | | | | |
|  | | | | |
| **希望洽談內容(※必填)** | | | | |
| **□銷售：**  **□進口：**  **□技術合作：**  **□共同合作向第三國發展:** | | | | |
| **希望洽談廠商(※必填，請依序填寫廠商編號。請參閱廠商資料)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | | **4.** | **5.** | **6.** | | | | | |
| **參與商談者資訊** | | | | |
| **參加者姓名** |  | **職稱** |  | |
| **公司電話/手機** |  | **E-mail** |  | |
| **參加人數** | **位** | **語言** | **□日文　□英文** | |

**★填寫完成後請將原檔回傳至：**[**maki.fan@mail.mirdc.org.tw**](mailto:maki.fan@mail.mirdc.org.tw)**，謝謝您的合作!**